

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2025-003

北京华大九天科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 545,437,608 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华大九天	股票代码	301269
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋鑫林	吴雪丽	
办公地址	北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座二层公司 董事会办公室	北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座二层 公司董事会办公室	
传真	010-84776889	010-84776889	
电话	010-84776988	010-84776988	
电子信箱	ir@empyrean.com.cn	ir@empyrean.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事用于集成电路设计、制造和封装的 EDA 工具软件开发、销售及相关服务业务。EDA 工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具，是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱

之一。随着集成电路产业的快速发展，设计规模、复杂度、工艺先进性等不断提升，EDA 工具的作用更加突出，已成为提高集成电路设计效率、加速产业技术进步与革新的关键因素。

公司产品包括全定制设计平台 EDA 工具系统、数字电路设计 EDA 工具系统、晶圆制造 EDA 工具、先进封装设计 EDA 工具和 3DIC 设计 EDA 工具等软件及相关技术服务。其中，全定制设计平台 EDA 工具系统包括模拟电路设计全流程 EDA 工具系统、存储电路设计全流程 EDA 工具系统、射频电路设计全流程 EDA 工具系统和平板显示电路设计全流程 EDA 工具系统；技术服务主要包括基础 IP、晶圆制造工程服务及其他相关服务。公司产品和服务主要应用于集成电路设计、制造及封装领域。报告期内公司产品及服务进展情况如下：

（1）公司产品进展及生态建设情况

公司秉持技术驱动发展战略，持续加大研发投入，凭借硬核创新突破关键技术壁垒，在数字芯片设计 EDA 系统、模拟设计 EDA 系统、存储芯片设计 EDA 系统、先进封装 EDA 系统及 3DIC 设计 EDA 系统等领域取得重大突破，相关产品已成功导入国内龙头芯片设计和制造企业的核心设计流程，有力支撑了客户的产品开发和大规模量产。

报告期内，公司成功新推出了 11 款 EDA 核心工具、创新性地构建了 9 大关键核心解决方案。此外，公司以 AI 创新、3DIC 突破和生态跃迁三大核心业务构建战略增长极：一是，AI+EDA 实现双向赋能打造“智能设计-智能硬件”闭环，不仅通过 EDA 智能设计驱动 AI 芯片设计效率革命、降低大模型训练成本、提升 AI 算力，同时大模型及算力提升反向带动 EDA 开发效率和业务提升；二是，依托国内唯一 3DIC 全流程 EDA 解决方案，率先突破 2.5D/3D 异构集成技术壁垒，抢占后摩尔时代算力芯片、存储芯片等制高点，具备很高的技术溢价能力；三是，通过 PDK 生态+数据底座自主化，构建设计-制造-场景全链路闭环，突破国产先进工艺生态壁垒。技术壁垒与国产替代双重红利叠加下，该三大核心业务相互协同，一方面有力支撑国产先进工艺设计，打造公司未来高成长引擎；另一方面抢抓时代先机，引领国产 EDA 创新方向，奋力在新赛道上实现弯道超车，成为全球 EDA 行业不可忽视的中国力量。

在 AI 创新方面，公司实现了 AI+EDA 双向赋能。一方面，通过 AI 赋能 EDA 工具革新。公司工艺诊断分析平台 Vision 通过 AI 图像处理技术实现全链路协同分析自动化，在晶圆轮廓预测、扫描电镜图像处理等领域取得突破性进展，晶圆图像量测工具 Vision ID 的轮廓提取效率提升 2 倍以上，晶圆轮廓预测工具 Vision HP 的平均预测误差控制在 2nm 以下。新推出 PyAether 智能体 Aether Coder 和平板显示电路物理验证伪过滤工具 ArgusFPD Triage AI，提升了工具智能化水平；另一方面，EDA 工具的创新反哺 AI 芯片发展，赋能 AI 芯片设计。分别通过 Aether Coder 和 ArgusFPD Triage AI 提升了芯片设计效率；Vision 解决了先进工艺芯片良率瓶颈；电源完整性分析签核工具 Hima EMIR 精准定位 AI 芯片在高算力、高功耗下的供电不稳与金属线老化风险，大幅压缩芯片设计迭代周期、提升流片成功率与有效

算力输出，从而降低大模型训练成本。

此外，公司自主开发的智能问答客服系统“天问”，依托 AI 大模型的自适应学习能力，实现常见问题的秒级响应，技术支持效率和客户满意度显著提高。

AI+EDA 双向赋能形成“智能设计-智能硬件”的正向循环，为半导体产业智能化转型提供关键支撑，助力全球 AI 芯片市场规模不断突破，从而带动公司在 AI 芯片领域 EDA 市场规模的突破。

在 3DIC 方面，公司前瞻性洞察到当前 AI、GPU、存储等芯片正依托 3DIC 技术突破后摩尔时代先进工艺及算力瓶颈，在 3DIC 设计 EDA 领域提前布局，构建了覆盖从异构集成三维芯片协同设计到验证的全流程解决方案，填补了国内高端 3DIC 设计工具的空白，是国内唯一的 3DIC 设计验证全流程 EDA 提供商。报告期内，公司新推出首款业界领先的 Argus 3DIC 物理验证平台，全面支持 2.5D/3D 异构集成封装设计，可实现 3DIC 多元化协同设计到封装的全链路物理验证。

在生态建设方面，公司联合产业联盟及合作伙伴，共同推进国产数据底座和标准体系的建设，逐步摆脱了对国外关键技术的依赖，实现了数据底座的自主可控。同时，公司与国内晶圆代工厂深度合作，开发的 PDK 套件覆盖国内晶圆代工厂 70% 以上的工艺节点，与公司全流程 EDA 产品互相配合形成闭环解决方案，推动国产 EDA 工具的大规模应用。公司的技术底座与生态协同有效推动国产化先进工艺的持续迭代与自主突破，不仅全面提升产品适配与工程化能力，更以核心工具链牵引产业链自主升级，构建起从设计工具、先进工艺到场景应用的健全生态，成为我国先进工艺自主发展不可或缺的关键力量。

在数字电路设计 EDA 领域，公司持续加大研发投入，新推出了四款产品，分别是数字仿真验证工具 Hima Sim、静态时序分析签核工具 Hima Time、数字 SoC 电源完整性分析签核工具 Hima EMIR 和数字芯片物理验证签核工具 Argus SoC 等用于数字芯片仿真验证和签核的核心 EDA 产品，不仅构建了完整的数字芯片验证和签核解决方案，而且丰富了公司数字 EDA 工具产品线，产品种类已覆盖数字电路设计主要工具的 80%。

在模拟电路设计 EDA 领域，公司新推出了四款产品，分别是智能化及自动化设计平台 Andes AMS、数模混合仿真工具 ALPS CS、可靠性仿真工具 ALPS Relion 和 PyAether 智能体 Aether Coder。Andes AMS 颠覆了传统设计模式，通过自动化流程，提升设计效率 2 倍以上；ALPS CS 支持千万晶体管级超大规模数模混合仿真，可无缝对接 UVM 验证环境，具备高易用性与强可移植性，能够快速切入现有仿真流程，大幅降低客户流程迁移成本；ALPS Relion 支持老化仿真、过压仿真、失效分析及良率分析，广泛应用于模拟、存储、射频电路设计，满足车规电子、工业电子及消费电子等领域日益增加的可靠性仿真需求；基于大语言模型（LLM）的 PyAether 智能体 Aether Coder，核心打造两大功能模块 API Search 模块（智能化 API 检索与信息匹配）和智能 Coder 模块（基于自然语言的自动化代码生成），分别解决开发过程中 API 检索与代码生成的关键问题，形成从资源查询到代码实现的一体化技术支持体系，缩短

用户设计周期，降低开发成本。

在存储电路设计 EDA 领域，公司全流程产品已经被大规模应用于头部存储芯片企业，有力支撑了国内存储芯片企业的长期健康发展。

在射频电路设计 EDA 领域，公司全流程产品与国内合作伙伴的 3D 电磁仿真工具集成，拓展了射频微系统应用领域的解决方案，同时新推出了声表面波滤波器（SAW）及体声波滤波器（BAW）前端设计解决方案，满足用户定制化滤波器模型开发要求。该平台已在硅基和化合物半导体射频龙头企业得到应用。

在平板显示电路设计 EDA 领域，公司全流程产品已经在国内 90%以上平板企业、前四大终端厂商、海外顶尖平板与终端巨头得到大规模应用。公司独创的千万像素级版图签核技术，成功实现良率提升 2-5%，设计周期缩短 1 倍，为千亿级平板显示产业集群的确定性增长注入强劲动力。报告期内，公司新推出两款产品，包括智动化平台 AndesFPD，借助智能化、自动化技术大幅提升设计效率；平板显示电路物理验证伪错误过滤工具 ArgusFPD Triage AI，通过多模态图像识别与大语言模型报错信息推理的双重验证机制，实现 98%的同类型伪错误过滤率且每万条数据处理时长低于 30 分钟，显著提升面板版图设计效率。

在晶圆制造 EDA 领域，公司构建了设计支撑完整解决方案、流片-光罩生成解决方案、良率分析解决方案和设计-制造协同优化（DTCO）解决方案，形成全流程技术支撑体系，为晶圆制造关键环节提供核心保障。其中设计支撑解决方案是国内唯一覆盖从 PDK 开发，设计开发到流片服务的全链条平台；流片-光罩生成解决方案解决了先进工艺下大规模版图数据验证耗时长和 TB（太字节）级光罩生成难以突破 8 小时的两大瓶颈问题；良率分析解决方案采用 AI 驱动技术前瞻性识别工艺缺陷，准确率达 99%，有效助力客户快速提升产品良率；设计-制造协同优化（DTCO）解决方案从物性和电性两个方向指导工艺调优，促进设计更好的适配工艺，以取得更优的设计性能-功耗-面积（PPA）和工艺良率。

在先进封装设计 EDA 领域，公司先进封装 EDA 平台已具备支撑高端 AI 芯片、GPU、高性能处理器芯片等 Chiplet 芯粒设计的能力。该平台解决了先进封装工艺下超大规模版图设计和物理验证的瓶颈，显著提升了超大规模芯片封装设计效率。

（2）公司产品技术认证情况

公司多款 EDA 工具获得晶圆制造商认证。电路仿真工具 ALPS 获得 8nm/5nm/4nm 认证、晶体管级电源完整性分析工具 Patron 获得 14nm 认证、物理验证工具 Argus DRC/LVS 获得 28nm 认证。

原理图/版图编辑工具 Aether、电路仿真工具 ALPS、物理验证工具 Argus、寄生参数提取工具 RCExplorer、功率器件可靠性分析工具 Polas、晶体管级电源完整性分析工具 Patron、单元库/IP 质量验证工具 Qualib 和高精度时序仿真分析工具 ICEplorer-XTime 等八款工具获得 ISO 26262 TCL3 和

IEC 61508 T2 国际标准认证，能够支持汽车安全完整性标准最高 ASIL D 级别的芯片设计。

(3) 公司技术服务进展情况

除了在 EDA 工具领域持续发力外，公司工程技术服务也发展迅速，与 EDA 软件产品相互配合给客户带来更加丰富、高效的解决方案。服务内容包括基础 IP 核开发、测试芯片设计、晶圆及 IP 核测试、SPICE 模型提取、PDK 开发等。目前公司已成为国内领先的晶圆制造工程服务供应商和基础 IP 供应商。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	6,327,842,567.91	5,628,841,870.04	12.42%	5,535,537,490.15
归属于上市公司股东的净资产	5,252,047,481.67	5,004,226,114.18	4.95%	4,783,344,777.09
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	1,324,976,566.63	1,222,354,443.47	8.40%	1,010,402,077.64
归属于上市公司股东的净利润	60,983,525.27	109,478,790.34	-44.30%	200,722,810.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,802,570.01	-57,067,673.63	82.82%	64,011,757.59
经营活动产生的现金流量净额	560,653,590.02	-51,777,109.44	1,182.82%	248,516,687.44
基本每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45.00%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45.00%	0.37
加权平均净资产收益率	1.19%	2.24%	-1.05%	4.26%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	234,322,703.68	267,214,254.94	303,237,853.61	520,201,754.40
归属于上市公司股东的净利润	9,713,941.82	-6,646,027.97	5,992,352.00	51,923,259.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-387,804.28	-18,233,211.35	-3,535,313.24	12,353,758.86
经营活动产生的现金流量净额	240,261,680.32	2,952,255.43	-58,604,319.27	376,043,973.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,762	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,621	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
中国电子有限公司	国有法人	21.12%	115,200,804.00	0.00	不适用	0.00			
北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.92%	81,369,518.00	0.00	不适用	0.00			
中电金投控股有限公司	国有法人	12.78%	69,700,000.00	0.00	不适用	0.00			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	8.34%	45,478,067.00	0.00	不适用	0.00			
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	6.55%	35,706,442.00	0.00	不适用	0.00			
国新投资有限公司	国有法人	3.99%	21,765,574.00	0.00	不适用	0.00			
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.57%	14,036,732.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	其他	2.15%	11,747,167.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	6,158,312.00	0.00	不适用	0.00			
北京诚旻投资有限公司—诚旻战略新兴产业私募证券投资基金	其他	0.75%	4,099,835.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东“中国电子有限公司”和“中电金投控股有限公司”均为“中国电子信息产业集团有限公司”的控股子公司，互为一致行动人；2、除以上情况外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。								

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

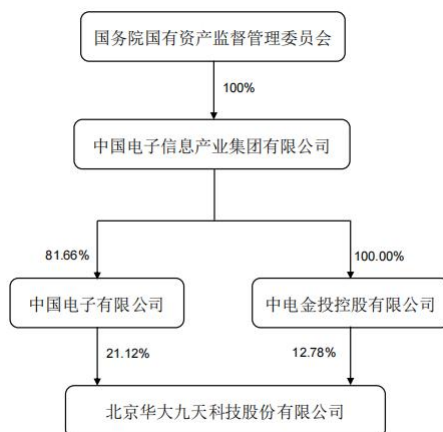
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无。